

# **Transfer Molding System**

**Model YPM1080-EP**



**Transfer molding system applicable for  
exposed die molding and varying package thickness**

# 适用于芯片露出成形和塑封厚度可变的 注塑成形设备

产品信息



中文

- 根据独特的模具驱动系统，实现高品质的芯片露出封装
- 因为可通过此装置调整封装体的厚度・基板的厚度，所以仅此一台装置即可对应多种产品
- 采用了最时候MUF封装的构造
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



## SPECIFICATION

| Items          |      | Unit      | Description                                 |              |              |              |
|----------------|------|-----------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 机型             |      | —         | YPM1080-EP                                  |              |              |              |
| 框架・基板类型        |      | —         | 基板                                          |              |              |              |
| 基板尺寸           | 长度   | mm        | 150—241                                     |              |              |              |
|                | 宽度   | mm        | 60—95                                       |              |              |              |
| 树脂             | 径    | mm        | φ 14, 16                                    |              |              |              |
|                | 长度   | mm        | 15.4—35.0                                   |              |              |              |
| 机械时间           |      | sec       | Approximately 40 (45*)                      |              |              |              |
| 外形尺寸           | 模组数量 | module    | 1                                           | 2            | 3            | 4            |
|                | 宽度   | mm        | 2,540                                       | 3,220        | 3,900        | 4,580        |
|                | 纵深   | mm        | 2,000                                       | 2,000        | 2,000        | 2,000        |
|                | 高度   | mm        | 1,980                                       | 1,980        | 1,980        | 1,980        |
| 重量             |      | ton       | 6.5 (6.6*)                                  | 10.1 (10.3*) | 13.7 (14.0*) | 17.3 (17.7*) |
| 每模成形基板数量       |      | workpiece | 2                                           | 4            | 6            | 8            |
| 进料盒空间          |      | mm        | 440                                         |              |              |              |
| 出料盒空间（插片式收料方式） |      | mm        | 440                                         |              |              |              |
| 合模压力           |      | kN／(tf)   | 49.0—784.0／5.0—80.0                         |              |              |              |
| 注塑压力           |      | kN／(tf)   | 3.92—49.0／0.4—5.0 (2 step pressure setting) |              |              |              |
| 品种切换方式         |      | —         | 采用KIT更换方式                                   |              |              |              |
| 可以安装的模具        |      | —         | YPM1080-EP租用模具                              |              |              |              |
| 使用分离膜的宽度       |      | mm        | 100—300                                     |              |              |              |

- ・以上数值仅为本公司装置的标准配置
- ・需要改良的时候，规格可能会有所变更
- ・如有特殊系统规格要求，可与我们讨论
- ・\*的值是用于分离膜规格



东和半导体设备（上海）有限公司

中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A  
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标）， 是TOWA株式会社的商标或注册商标。

## Overseas Sales Contacts

### Japan/Headquarters

TOWA Corporation

### China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.  
TOWA Taiwan Co., Ltd.

### Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

### Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

### Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

### Philippines

TOWA Semiconductor Equipment  
Philippines Corp.

### Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

### India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA  
PRIVATE LIMITED

### Germany

TOWA Europe GmbH

### Netherlands

TOWA Europe B.V.

### the United States

TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ